

苏州德龙激光股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投2026-003

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	全体通过网络互动方式参与德龙激光2026年半年度业绩说明会的投资者
时间	2026年9月17日
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理：赵裕兴 董事、副总经理、董事会秘书：袁凌 财务总监：李苏玉 独立董事：蒋力

投资者关系活动主要内容

一、 问答环节

（一）请介绍公司 2026 年上半年整体经营业绩情况，营业收入增长的主要驱动因素有哪些？

答：尊敬的投资者您好！公司 2026 年上半年整体经营业绩情况如下：2026 年上半年公司实现营业收入 26,638.71 万元，较上年同期下降 6.60%，2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3,817.60 万元，比同期下降 2,269.16 万元，主要原因为：

1、公司上半年新签订单增长较快，为保障交付质量，公司资源向订单交付环节侧重，验收推动不及预期，设备收入同比下降；

2、销售费用比上年同期增加 333.96 万元，主要是为支持销售订单，销售相关的人员费用有一定增加；

3、管理费用比上年同期增加 566.42 万元，主要是①江苏德龙一期土建工程上年末竣工，折旧和摊销费用比上年同期增加；②公司布局新加坡、上海等子公司，前期人力费用有所增加；

4、财务费用较上年同期增加 264.40 万元，主要是汇兑净损失增加。

但与此同时，报告期内公司合同负债（主要是预收货款）增长 72.56%，在手订单及客户预付款项均呈上升态势，充分印证公司业务发展态势向好，随着在手订单的陆续验收与收入确认，公司经营业绩有望改善。

未来营收增长的主要驱动因素：新产品、新技术是公司未来营收增长的关键。受益于 AI 算力需求增长带动存储芯片产业发展，以及光通信产业升级等行业趋势，公司持续推进技术创新和产品迭代，陆续推出了存储芯片隐形切割设备、PCB/FPC 激光切割及钻孔解决方案、玻璃基板、陶瓷基板、金刚石等激光解决方案，并积极推进相关产品的市场拓展。此外，在光伏领域自研 120W 皮秒绿光激光器，以及 5 万瓦级半导体激光均匀加热系统等，均为盈利增长奠定了坚实基础。公司聚焦核心重点客户，做深做透专属服务，通过标杆案例辐射带动行业市场拓展。同时持续推进降本增效，优化组织架构与资源配置，全方位提升盈利水平，以实现可持续的高质量发展。感谢您对德龙激光的关注！

（二） 请问公司对市值管理是怎么规划的？公司目前的合理市值应该是多少？公司是否有回购计划？

答：尊敬的投资者您好！公司高度重视市值管理工作，坚持以提升公司长期价值为核心导向，助力公司高质量发展，切实提升股东回报。公司通过业绩说明会、投资者交流会、投资者热线、投资者邮箱、上证 E 互动及股东会等多种方式持续接待机构投资者和中小投资者，加大沟通力度，打造高效透明的交流平台，为投资者提供真实、准确、完整、及时、公平的信息披露。市值波动受宏观政策、市场环境等多重因素影响，请注意投资风险。公司于 2024 年完成一次股份回购，已实际回购股份 350,000 股，占公司总股本的 0.3386%，支付的资金总额为人民币 10,064,348.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司暂未有其他回购计划。感谢您对德龙激光的关注！

（三） 公司的核心技术壁垒体现在哪些方面？研发投入情况如何？

答：尊敬的投资者您好！公司具有三大核心技术壁垒：

- 1、激光器技术：公司是国内少数能提供稳定的工业级固体超快激光器的厂商，也是国内较早实现超快激光器激光种子源自产的少数厂商之一，核心激光器技术处于行业领先水平；
- 2、激光加工工艺技术：经过20年以上的技术研发和工艺积淀，公司在激光加工工艺和特殊

光学系统设计等多方面形成关键核心技术，并掌握了激光器相关技术、激光应力诱导切割技术、激光剥离技术、硬脆材料激光切割技术、导电薄膜激光蚀刻技术、陶瓷基板激光加工技术、PCB激光加工技术、精密运动模组及控制技术、自动化集成技术等多项核心技术，在半导体、电子、新能源等领域形成产业化应用能力。

3、高精度运动平台：超15年运动机构及运动控制行业经验的专业工程技术团队，具有百纳米级运动精度、长行程移动式龙门技术、气浮导轨四轴控制技术、多轴联动控制技术和气浮导向等多项关键技术，为高端装备提供稳定可靠的运动平台。

研发投入方面，2026年上半年公司研发费用为6,324.72万元，占营业收入23.74%。感谢您对德龙激光的关注！

（四） 赵董好！请问公司的 FPC 软板钻孔/切割设备是否已经实现了批量供货？另外硬板方面，公司的 PCB 超快激光设备是否已经完成了头部客户测试验证？公司如何看待 PCB 领域激光加工设备未来两年的市场成长空间？这是否会成为公司业务增长最快的领域？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！公司在PCB方向拥有包括应用于PCB硬板、FPC软板、软硬结合板等线路板材料的切割、打标、钻孔等成熟的激光精细微加工产品矩阵。其中，公司的FPC软板钻孔/切割设备已成功导入多家行业客户实现量产应用；针对AI PCB材料推出的超快激光钻孔设备，目前已形成少量收入。公司关注到数据中心和AI芯片带来的硬板多层板超快激光钻孔机会，已在积极布局推进中，公司将持续推进相关产品的市场拓展，具体业务进展请以公司披露的定期报告为准。感谢您对德龙激光的关注！

附件清单（如有）	无
日期	2026年9月17日